文章编号: 0258-7025(2008)03-0462-04

激光功率密度对 Ge 烧蚀蒸气动力学特性的影响

吴东江1 许 媛2 尹 波1 王续跃1

(¹大连理工大学精密与特种加工教育部重点实验室, 辽宁大连 116024;²黄山学院信息工程学院, 安徽 黄山 245021)

摘要 建立了一维半导体 Ge 激光烧蚀模型,对不同功率密度的紫外激光烧蚀半导体 Ge 的过程进行了模拟,并对 计算结果进行了分析,得到激光功率密度对烧蚀过程以及蒸气膨胀动力学特性的影响。结果表明,激光功率密度 的变化对烧蚀过程影响非常大。照射的激光功率密度越大,靶的表面温度越高,蒸发深度、烧蚀蒸气温度和膨胀的 速度、相应蒸气膨胀的空间尺度也越大,且等离子体屏蔽现象出现得越早。在给定的烧蚀条件下,等离子体屏蔽的 阈值在 1×10⁸~1.5×10⁸ W/cm²之间。

关键词 激光技术;等离子体;数值模拟;脉冲激光烧蚀;晶体 Ge 中图分类号 TN 249;O 411.3 **文献标识码** A

Dynamic Property Influence of Ge Plume with Laser Power Density

Wu Dongjiang¹ Xu Yuan² Yin Bo¹ Wang Xuyue¹

 ⁽¹Key Laboratory for Precision and Non-Traditional Machining Technology, Ministry of Education, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116024, China
 ² School of Information Engineering, Huangshan University, Huangshan, Anhui 245021, China

Abstract One-dimensional dynamic semiconductor model was presented. The model has been used to investigate the influence of different laser power density on the laser ablation and the expansion of plume. The laser ablation is greatly influenced by laser power density. The more intensive the laser power density is, the higher surface temperature it would have. In this case, the depth of evaporation, the temperature of vapor, and the expansion velocity and spatial scale of ablated plume will also increase with the rising of laser power density. Meanwhile the more intensive the laser power density is, the earlier the plasma shielding would appear. For the given conditions, the threshold of plasma shielding value is between 1×10^8 W/cm² and 1.5×10^8 W/cm².

Key words laser technique; plasma; numerical simulation; pulsed laser ablation; Ge crystal

1 引 言

硅(Si)、锗(Ge)等半导体材料作为 CMOS 电 路、IC 芯片的核心材料,在半导体光电集成领域具 有十分重要的地位,而脉冲激光烧蚀技术(PLA)作 为一种最近发展起来制备纳米材料的高端技术,在 制备半导体纳米材料方面有着一定的技术优势和诱 人的应用前景^[1,2]。由于它是一种新生技术,存在 一些有待解决的问题,如出产率低,纯度不够高,制 备的材料质量、性能不稳定,对于制备大量的纳米材 料存在烧蚀过程中的反向散射等问题,该技术在很 大程度上取决于烧蚀过程(激光参数、背景环境)和 烧蚀产物的膨胀行为。了解脉冲激光烧蚀过程以及 激光参数对烧蚀过程的影响对于优化参数、提高加 工质量是非常重要的。

因此,对脉冲激光烧蚀半导体的过程和机制的 研究,对半导体纳米材料制备技术的进步和光电子 学的发展有着重要的指导意义。但是,用于制备纳 米材料所用的激光脉宽非常短(ns~fs),通过实验 检测的手段很难得到烧蚀阶段烧蚀产物的动力学特 性及演化过程。建立数值模型,分析对脉冲激光烧 蚀过程和烧蚀蒸气的动力学特性及演化过程成为一 种最经济有效的方法^[3]。一些专家、学者对脉冲激 光烧蚀过程提出了许多理论模型,但是大多数模型 是建立在研究脉冲激光烧蚀金属导体^[4~8]的基础上

收稿日期:2007-09-05; 收到修改稿日期:2007-11-01

基金项目:国家自然科学基金重大项目(50290101)和辽宁省自然科学基金(20062178)资助课题。 作者简介:吴东江(1964—),男,山东人,教授,主要从事精密与特种加工方面的研究。E-mail;djwudut@dlut.edu.cn

的,对激光烧蚀半导体的过程及机制的研究却较 少^[9]。本文建立了一维半导体烧蚀模型,研究激光 功率密度对烧蚀过程以及烧蚀蒸气膨胀的影响。

2 理论模型的描述

物质对激光的吸收与其电子能带结构有关,对 不同类型(导体、半导体、绝缘体)的材料,激光烧蚀 机制也不相同。Ge的禁带宽度为0.67 eV,对于波 长为248 nm的激光,其光子能量为5 eV,远远大于 Ge的禁带宽度,能直接激发 Ge的价带电子向导带 跃迁,本文利用 Ge的各向同性以及其电子电离能 级分布与金属导体非常相似的特点,在 Zhaoyang Chen 等提出的金属导体激光烧蚀模型^[6]的基础上 发展了一维半导体激光烧蚀模型,对波长为248 nm 的高斯型脉冲激光烧蚀晶体 Ge 和烧蚀蒸气在背景 气体(He)环境下膨胀的动力学行为进行模拟。

对于纳秒脉冲激光烧蚀,激光脉冲宽度远大于 电子与离子间的能量弛豫时间,可以认为材料处于 局域热力学平衡状态,用一维单温的热传导方程来 描述激光与材料的相互作用。当 Ge 靶表面温度上 升到气化温度时,表面将出现气化现象,烧蚀蒸气在 背景气体环境下膨胀。膨胀初期阶段,假设蒸气是 处在局域热力学平衡下的连续性介质,用一维的纳 维-斯托克斯(Navier-Stokes)方程组来描述。模型 中,只考虑 Ge 的一阶、二阶电离,He 的一阶电离, 处于热力学平衡状态下蒸气的电离度可通过沙哈方 程估算。对于紫外激光烧蚀过程,激光等离子体吸 收入射激光能量的主要机制是逆轫致吸收机制和原 子激发态的光致电离吸收机制,而逆轫致吸收又分 为电子-离子碰撞吸收和电子-中性粒子碰撞吸收。 详细模型和有关参数的计算公式可以参考文献[6]。

3 计算结果与分析

为了分析激光功率密度对烧蚀过程的影响,对波 长为248 nm,峰值功率密度分别为1×10⁸ W/cm², 1.5×10⁸ W/cm², 2.0×10⁸ W/cm², 3.0×10⁸ W/cm², 4.0×10⁸ W/cm²和5.0×10⁸ W/cm²的高斯型(半峰 全宽为7 ns)脉冲激光在133.3 Pa氦气环境下烧蚀 晶体 Ge 的计算结果进行分析。

3.1 激光功率密度对等离子体屏蔽的影响

脉冲激光照射在晶体 Ge 表面,Ge 被迅速地加 热熔化蒸发,当激光功率密度足够高时,蒸气会发生 电离,形成等离子体向外膨胀。在膨胀过程中等离 子体吸收激光能量,无形中阻止了激光到达靶面,切



图 1 脉冲激光功率密度随时间变化曲线(实线)和到达靶面的激光功率密度随时间变化的曲线(虚线) Fig. 1 Laser intensity-time profiles for different values of laser irradiance. The solid line respresents the original laser pulse and the dashed lines represent the calculated laser intensities arriving at the target, after passing through the plasma

光

断了激光与靶的能量耦合,即出现等离子体屏蔽现 象。因此,实际与靶作用的激光,是穿过蒸气层后的 激光束。图1给出了不同峰值功率密度的激光脉 冲,其初始的功率密度随时间的变化(实线)以及穿 过蒸气层到达靶面的功率密度随时间的变化(虚 线)。如图所示,峰值功率密度为1×10⁸ W/cm²的 激光脉冲烧蚀 Ge 靶时,没有发生等离子体屏蔽现 象。说明此时烧蚀蒸气就像一层薄的透明介质,激 光束穿过蒸气不发生衰减。当脉冲的峰值功率密度 提高为1.5×10⁸ W/cm²时,在12 ns时出现了等离子 体屏蔽现象,但屏蔽现象不明显,说明蒸气对激光能 量的吸收很小。当脉冲的峰值功率密度为 3.0×10⁸ W/cm² 时,在8 ns左右出现了等离子体屏 蔽现象;当脉冲的峰值功率密度为5.0×10⁸ W/cm² 时,在5 ns左右就出现等离子体屏蔽现象。由此可 见,激光功率密度越高,屏蔽现象出现越早,且在上 述给定的条件下,等离子体屏蔽的阈值在1×10°~ $1.5 \times 10^8 \, \text{W/cm}^2$ 之间。

3.2 激光功率密度对靶面温度和蒸发深度的影响

图 2(a),(b)分别描述了图 1(a),(c),(d)所示 的激光脉冲烧蚀晶体 Ge,靶面温度和蒸发深度随时 间 的 变 化。当 激 光 脉 冲 峰 值 功 率 密 度 为







 1×10^8 W/cm²时, 靶面在10 ns左右达到最高温度 5700 K; 当激光脉冲的峰值功率密度提高到 3×10^8 W/cm²时, 靶面在10 ns之前就达到最高温度 7500 K; 当激光脉冲的峰值功率密度为 5×10^8 W/cm²时, 靶面在更短时间内达到最高温度 8500 K。且在相同时刻, 功率密度较高的激光脉冲 照射靶面, 得到的表面温度较高。由此得出, 激光功 率密度越大, 靶面温度就越高, 并且达到最高温度所 用时间越短。

在模型中,认为当温度达到气化温度时,材料就 被蒸发去除,所以蒸发深度也是烧蚀深度。从图 2 (b)看出,当峰值功率密度为1×10⁸ W/cm²的脉冲 激光烧蚀 Ge 时,蒸发深度为15 nm;当脉冲峰值功 率密度提高到3×10⁸ W/cm²时,蒸发深度为40 nm; 当脉冲峰值功率密度提高到5×10⁸ W/cm²时,蒸发 深度达到70 nm。由此可见,照射的激光功率密度越 大,蒸发深度也越大。

3.3 激光功率密度对蒸气膨胀的影响

图 3(a),(b)分别描述了图 1(a),(c),(d)所示 的激光脉冲烧蚀晶体 Ge,17 ns时刻烧蚀蒸气的温 度和膨胀的速度的空间分布。由图可知,当激光峰 值功率密度为1×10⁸ W/cm²时,烧蚀蒸气的温度只



图 3 17 ns 时刻激光功率密度对烧蚀蒸气温度(a)和 膨胀速度(b)的影响

Fig. 3 Calculated plume temperature (a) and expansion velocity (b) at different laser irradiances

有几千开;当激光峰值功率密度提高到3×10⁸ W/cm² 时,烧蚀蒸气的温度达到 20000~30000 K之间;当 峰值功率密度提高到5×10⁸ W/cm² 时,烧蚀蒸气的 温度达到 25000~35000 K之间。由此得出,激光功 率密度越高,烧蚀蒸气的温度也越高。

从图 3(b)可以看出,在同一时刻,当激光峰值 功率密度为1×10⁸ W/cm²时,烧蚀蒸气膨胀的最大 速度只有 2000 m/s;当峰值功率密度为 $3×10^8$ W/cm² 时,蒸气膨胀的最大速度达到 15000 m/s;当峰值功率密度达到 $5×10^8$ W/cm²时, 蒸气膨胀的最大速度达到17000 m/s。由此得出,激 光功率密度越高,烧蚀蒸气膨胀的速度越大。



图 4 烧蚀蒸气膨胀的空间尺度随激光功率密度的变化 Fig. 4 Calculated plume length as a function of laser irradiance

图4描述了烧蚀蒸气膨胀的空间尺度随激光功 率密度的变化。如图所示,10 ns时,激光功率密度 的变化对烧蚀蒸气膨胀的空间尺度影响并不明显, 虽然不明显,但仍然能观察到烧蚀蒸气的膨胀尺度 随激光功率密度增大而增大的趋势,随着时间的推 移,变化趋势更加明显。由此可知,蒸气膨胀的空间 尺度随激光功率密度增大而增大,且膨胀的时间越 长变化趋势越明显。

4 结 论

在紫外激光脉冲与半导体 Ge 相互作用基本理 论的基础上,建立了一维的半导体烧蚀模型。对不 同条件下的烧蚀过程 ($\lambda = 248 \text{ nm}$,峰值功率密度 分 别 为 $1 \times 10^8 \text{ W/cm}^2$, $1.5 \times 10^8 \text{ W/cm}^2$, $2.0 \times 10^8 \text{ W/cm}^2$, $3.0 \times 10^8 \text{ W/cm}^2$, $4.0 \times 10^8 \text{ W/cm}^2$, $5.0 \times 10^8 \text{ W/cm}^2$,半峰全宽为7 ns的高斯型脉冲在 气压为133.3 Pa的氦气环境下)进行模拟,并对计算 结果进行分析,得到不同激光功率密度对激光烧蚀 过程以及烧蚀蒸气动力学特性的影响,结论如下:

激光功率密度的变化对烧蚀过程影响很大。
 照射的激光功率密度越大,靶的表面温度越高,蒸发 深度越大;

2)激光功率密度越大,烧蚀蒸气的温度和膨胀的速度越大;

3)照射的激光功率密度越大,等离子体屏蔽现 象出现越早。在上述给定的烧蚀条件下,等离子体 屏蔽的阈值在1×10⁸~1.5×10⁸ W/cm²之间。

参考文献

- 1 Lou Qihong, Zheng Jun, Wei Yunrong et al.. Synthesis of nanometer crystal and semiconductor compound powders by excimer laser ablation [J]. Chinese J. Lasers, 1999, A26(1):85 ~88
 - 楼祺洪,郑 隽,魏运荣等.利用准分子激光制备晶体和半导体的纳米粒子[J].中国激光,1999,A26(1):85~88
- 2 Fu Guangsheng, Chu Lizhi, Zhou Yang et al.. Influence of pulse repetition rate on morphology of nanocrystalline silicon film prepared by pulsed laser deposition [J]. Chinese J. Lasers, 2005, **32**(9):1254~1257
 (前亡任 法六十 用 四 第 第次股份据要求任何来 S: 目前開展的

傳广生,褚立志,周 阳等.激光脉冲频率对纳米 Si 晶薄膜形貌 的影响[J]. 中国激光, 2005, **32**(9):1254~1257

3 Li Xiaoxi, Jia Tianqing, Feng Donghai et al.. The ablation mechanism and ultra-fast dynamics property of LiF with the ultra-short pulse laser [J]. Acta Optica Sinica, 2005, 25(11): 1526~1530

李晓溪, 贾天卿, 冯东海等. 超短脉冲照射下氟化锂的烧蚀机理 及其超快动力学研究[J]. 光学学报, 2005, **25**(11):1526~1530

- 4 Danny Perez, Laurent J. Lewis. Ablation of solids under femtosecond laser pulses [J]. Phys. Rev. Letts., 2002, 89(25): 255504-1~255504-4
- 5 M. Aden, E. Beyer, G. Herziger. Laser-induced vaporisation of metal as a Riemann problem [J]. J. Phys. D: Appl. Phys., 1990, 23:655~661
- 6 Zhaoyang Chen, Annemie Bogaerts. Laser ablation of Cu and plume explansion into 1 atm ambient gas [J]. J. Appl. Phys., 2005, 97(6):063305-1~063305-12
- 7 Zhaoyang Chen, Davide Bleiner, Annemie Bogaerts. Effect of ambient pressure on laser ablation and plume expansion dynamics: A numerical simulation [J]. J. Appl. Phys., 2006, 99(6):063304-1~063304-9
- 8 Annemie Bogaerts, Zhaoyang Chen. Effect of laser parameters on laser ablation and laser-induced plasma formation: A numerical modeling investigation [J]. Spectrochimica Acta Part B, 2005, 60(9-10):1280~1307
- 9 Xu Yuan, Wu Dongjiang, Liu Yue. Numerical simulation on plasma characteristics of Ge ablated by pulse laser [J]. *High Power Laser and Particale Beams*, 2007, **19**(9):1561~1566 许 媛,吴东江,刘 悦. 脉冲激光烧蚀 Ge产生等离子体特性的 数值模拟[J]. 强激光与粒子束, 2007, **19**(9):1561~1566